電子封裝機房的散熱與分析

摘要

電子和光電產品正趨向於薄和短。然而，功能和速度仍不斷提升。隨著積體電路的密度和性能提升，散熱變得越來越困難。因此，如何確保良好的散熱成為一個重要問題。有六種熱機房的冷卻方法。在本研究中，我們著重於主動對流和空間改造方法以達到更好的冷卻效果。ANSYS軟體被用於熱仿真和分析。我們能夠透過ANSYS識別出熱散熱的負面因素。然後，我們改變機房的地理位置以實現良好的熱散熱和湍流減緩，這是在ANSYS環境中進行的。

關鍵詞: 熱分析, IC包裝, 湍流減緩。

參考文獻

1. ANSYS Icepak 電子散熱基礎教程 王永康 編著
2. NCHC教育訓練網
3. DIGITIMES企業IT
4. 虎門科技
   http://140.127.118.1/laboratory/fml/Links/Ansys_Html/Ansys_Introductin.htm
5. ANSYS Icepak
6. 恩碩科技
   http://www.aonesoft.net/ansys/icepak.html
7. ANSYS
   http://www.ansys.com/zh-TW/Products/Electronics/ANSYS-Icepak/Icepak-Features